

2024

 알엔투테크놀로지

Investor Presentation





Company Information

- Company overview
- Board of Directors
- Brief History
- Stock Information

Company Overview

Ceramic Total Solution

알엔투테크놀로지는 원천 소재 기술을 바탕으로 MCP소재와 이를 활용한 다층 세라믹 공정을 통해 무선통신장비용 부품 및 전력반도체 파워모듈용 세라믹 방열기판, 방위산업용 다층세라믹 기판 등 제품의 원료부터 완성품까지 고객이 필요로 하는 최적의 다층회로 부품, 다층세라믹 기판 솔루션을 제공합니다.

회 사 명	알엔투테크놀로지
-------	----------

대표이사	이효종
------	-----

주요사업	무선통신용 부품, 소재, 다층 세라믹 PCB 전력반도체용 세라믹 방열 기판
------	--

설 립 일	2002년 3월
-------	----------

직 원 수	133명 (2023년 12월 기준)
-------	---------------------

자 본 금	3,823,244,500원
-------	----------------

동탄 사업장 ▼

강릉 사업장 ▼



Board of Directors

·서울대학교 재료공학 박사

이 효 종

CEO

- Univ. of Southern California, MBA
- 前) ABeam Consulting Korea, 부사장
- 前) Deloitte Consulting Korea, 본부장

민 보 홍

COO/VP

- 서울대학교 재료공학 석사
- 前) LG금속 기술연구소
- 前) 아모텍 기술연구소

육 점 국

연구/기획

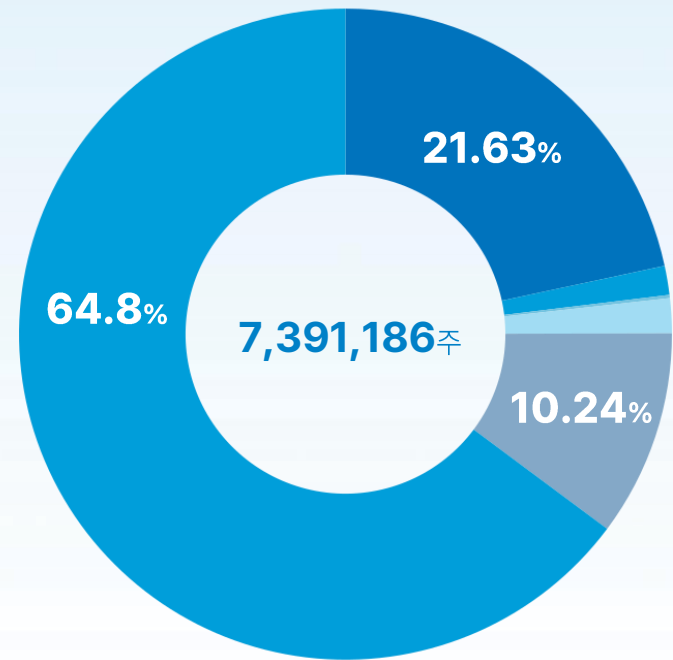
Brief History



Stock Information

주식 현황

구분	종류	주식수	비율
최대주주	보통주	1,598,730	21.63
특수관계인	보통주	106,374	1.44
우리사주조합	보통주	12,154	0.16
자기주식	보통주	128,000	1.73
1% 초과주주	보통주	756,469	10.24
소액주주	보통주	4,789,459	64.8



■ 최대주주 ■ 특수관계인 ■ 우리사주조합 ■ 자기주식 ■ 1% 초과주주 ■ 소액주주



02

Business Information

• Core Technology	• RN2's MCP Foundry Service	• Growth Road Map
• Biz. Product	• Strength of RN2 MCP	• 세라믹 방열기판 _ 구조, 강점, 시장
• Global Customer	• MCP Supply Chain	• Growth Road Map
• Biz. Highlight	• 세라믹 방열기판 / 방위산업용 MCP	• Telecom.
• MCP Application	• 2024년 전망	• 2024 Marketing

Core Technology

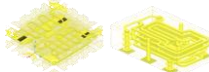
* MCP(Multi-layer Ceramic PCB, 다층 세라믹 기판)

Over 20 Years' MCP Technology

Materials



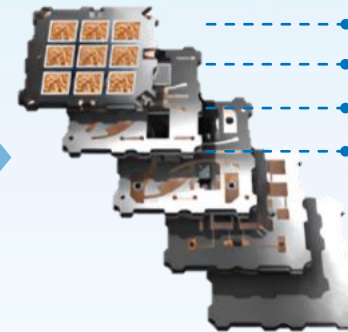
RF Design



Processing



- Excellent Performance at High Frequency
- Outstanding Reliability
- Multifunction, Smaller Size by Embedding Passives and Integrating Actives



- Printed Array Antenna
- Embedded Couplers
- Embedded MMICs, Mixers
- Embedded Resistors, Filters

일반 PCB	VS	MCP	
FR4	소재	Ceramic	
> 12 inch	크기	< 12 inch	대면적화 가능
-	강도	350MPa	고강도
< 200°C	내열성	< 800°C	4배 우수
2×10^{-2}	Dielectric Loss	1×10^{-3}	20배 우수
0.3W/mK	열전도도	3.0W/mK	10배 우수
17ppm/°C	열팽창 계수	4ppm/°C	Si 정합성
25kV/mm	절연 절압	25kV/mm	동등

Core Technology MCP Process

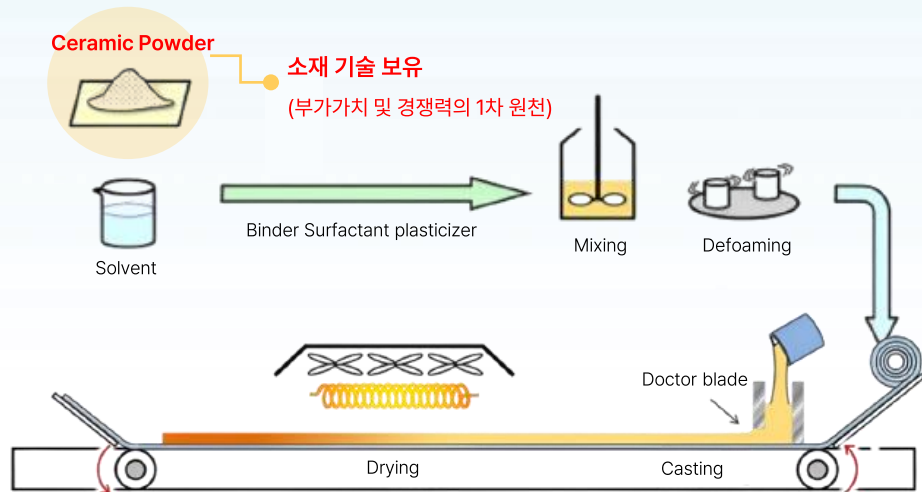
* MCP(Multi-layer Ceramic PCB, 다층 세라믹 기판)

20년 이상의 MCP 공정 및 제품 설계 Know-How 보유

MCP (Multi-layer Ceramic PCB, 다층 세라믹 PCB)

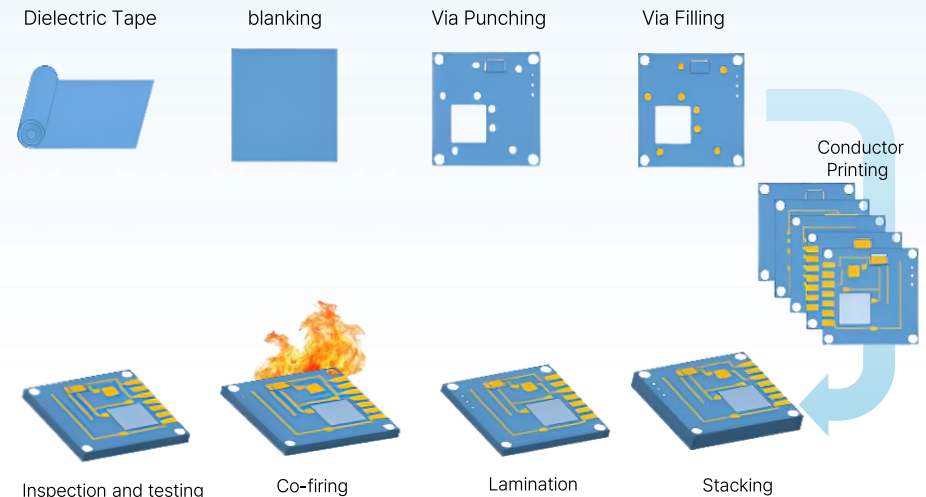
- 내부에 다양한 회로와 소자를 포함하여 다층으로 구성되고, Top 및 Bottom면에 반도체 Chip, MLCC 등의 표면 실장형 부품을 실장할 수 있어 PCB 역할을 수행
- 자동차, 방위산업, 통신산업 등 다방면으로 사용

세라믹 Tape 제조



출처: APL Energy

내부 회로를 포함하는 다층 세라믹 PCB(MCP)제조

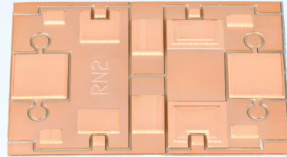
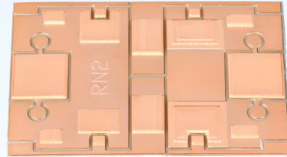
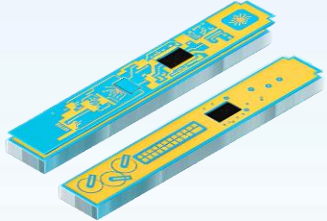


출처: IMT Atlantique

Business Product

* MCP(Multi-layer Ceramic PCB, 다층 세라믹 기판)

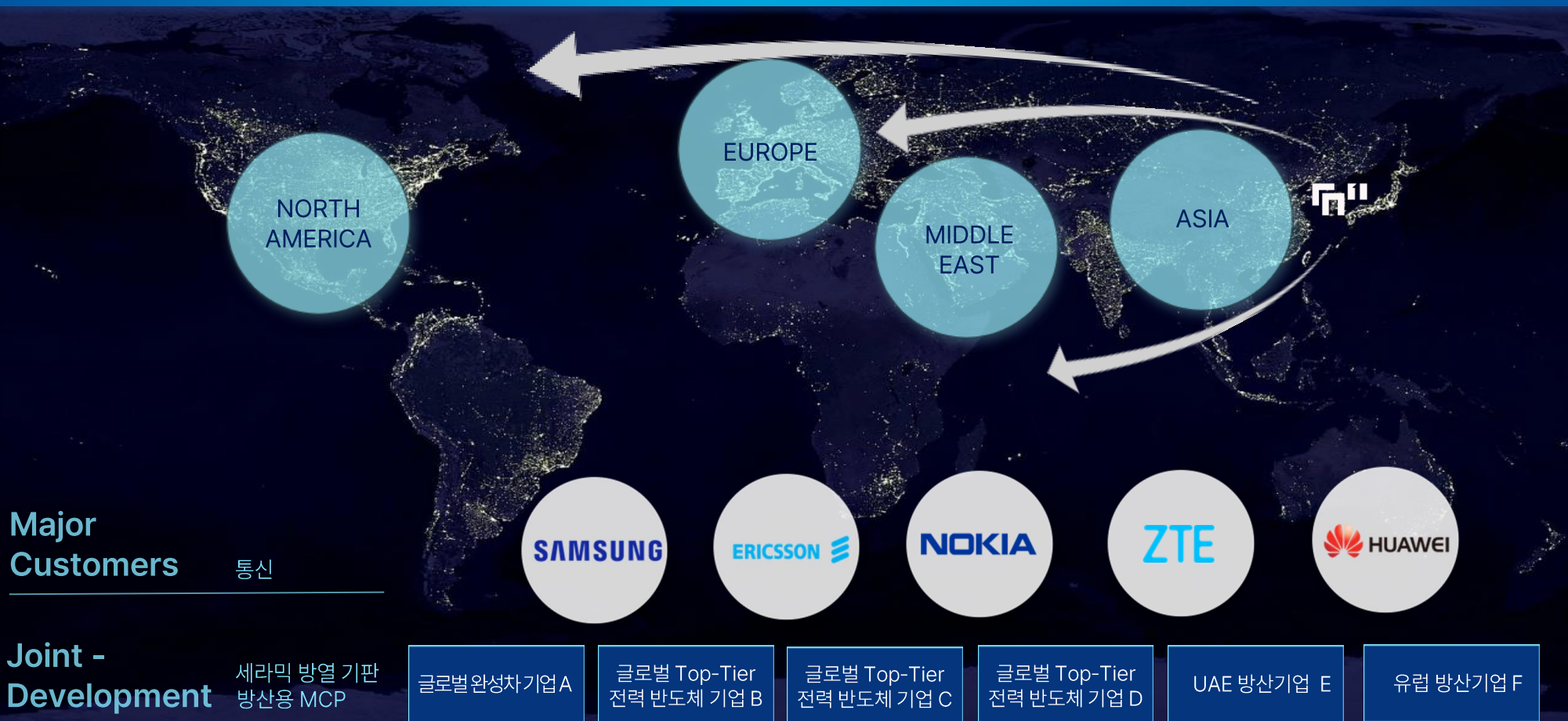
Products based on MCP Technology

이동통신		전기자동차		방위산업
Material	MLC	MCP		
				
MCP Powder	Coupler	Termination Attenuator	스페이스 일체형 방열기판	다층 세라믹 PCB
통신부품 RF BPF(Band Pass Filter)	이동통신 중계기 등 네트워크 장비 5G,4G / M-MIMO / Small Cells		전기자동차 인버터용	방위산업, 반도체, 영상의료기 등 TRX Module, Probe Card



Global Customers

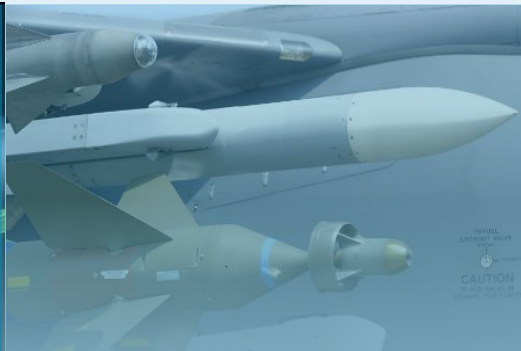
- 통신장비용 부품/소재 - 전세계 21개국 수출
- 세라믹 방열기판 / 방산용 MCP - 글로벌 Top-Tier 전력반도체기업 / 방산기업과 공동 개발 중



Business Highlight



신성장사업



Growth Engine



주력사업



Cash Cow

전력반도체용 세라믹 방열 기판 (MCP사업부문)

- 스페이서 일체형 세라믹 방열기판
- 차별화된 솔루션 확보를 통한 고객 니즈 충족
- 국내완성차업체및 글로벌 Top-Tier 전력반도체 기업과 공동 개발 진행 중

다층 세라믹 PCB (MCP사업부문)

- 20년 MCP Tech. Know-How
- VOC 기반 다양한 솔루션 제공
- 중등소재 글로벌 방산 기업과 1차 양산물량 테스트 진행 중
- 근거리 정밀 유도 방어 시스템용 MCP 모듈

통신 부품 (MLC사업부문)

- 차세대 통신장비용 부품 개발
- 신규 사업 기회 모색 (스마트폰용 UWM Ant.)

소재 (Material사업부문)

- 전자부품용 세라믹 원천 소재 기술
- 차세대 통신 장비용 소재 개발

MCP Application

* Red : Current RN2 Biz. Area

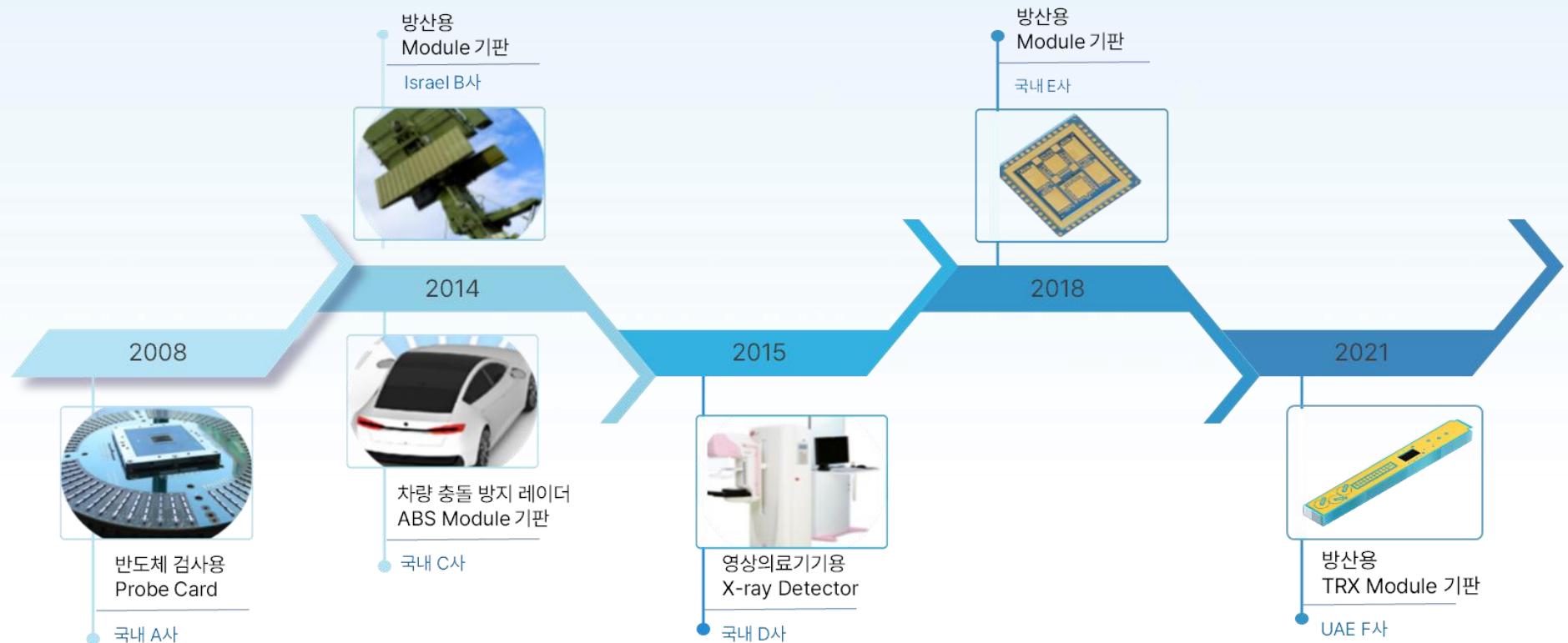
MCP (신성장 사업) – 다양한 산업군에서 핵심 부품으로 사용 중



RN2's MCP Foundry Service History

20년 이상의 공정 know-How 기반 으로 다양한 고객의 Needs 충족

회사 설립 이후 꾸준히 준비하고 진행 중인 MCP F/S사업 _ 방산용, 차량용, 가전용, 반도체용, 의료기기용 등



Strength of RN2 MCP 다층 세라믹 PCB

Why does RN2 have the strength for ceramic substrate business?

* D/G: Design Guide

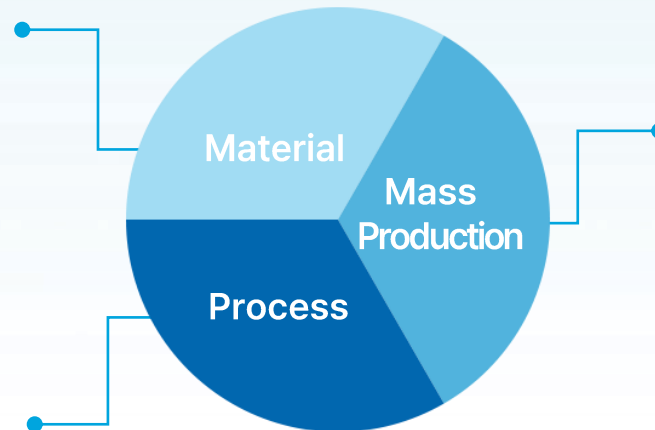
Material

- RN2 LTCC 세라믹 소재 (3 Patents)
- DuPont951 * D/G line-up
- Ferro A6ME D/G 개발 중
- Al or AlN or ZTA or Si3N4



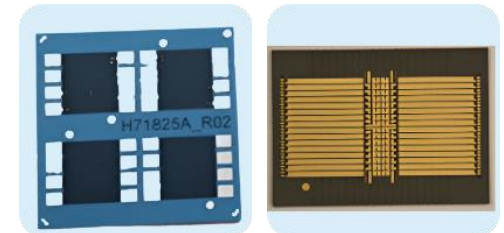
Process

- Fine via/pattern MCP 공정기술
- 3-D multi-layer implementation
- process library & D/G line-up

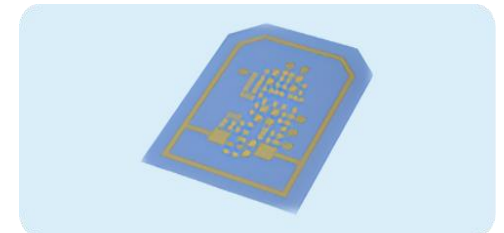


Mass Production

- Mass production experience for military
- 방산 & 의료용 MCP



방산용 MCP



의료용 MCP

MCP Supply Chain

* MCP(Multi-layer Ceramic PCB, 다층 세라믹 기판)

사업형태 구분	☒	소재	☒	소재		
	☒	MCP	☒	MCP	☒	MCP
	☒	Module				
MCP 전체 시장(%)	20%		55%		25%	
대표기업						
MCP 관련 당사 사업 영역			 MCP용 소재, 전기차용 방열기판, 방산용 기판, 의료용 기판 등			

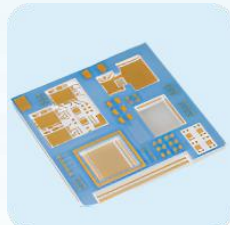
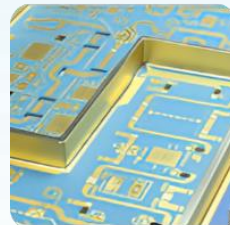
MCP 수요처 (모듈/디바이스 제조사)	<i>muRata</i>	HITACHI	NEC	Alcatel-Lucent 
		DELPHI		

소재



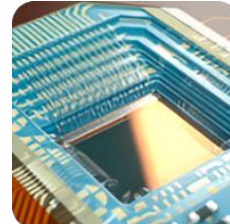

유전체 세라믹 파우더
유전체 세라믹 Sheet

MCP

세라믹 PCB

MCP Module

자동차용
센서용

세라믹 방열기판 전력반도체 파워모듈용

국내 완성차 기업 & 글로벌 Top-Tier 전력 반도체 기업들과 다수의 공동 개발 진행

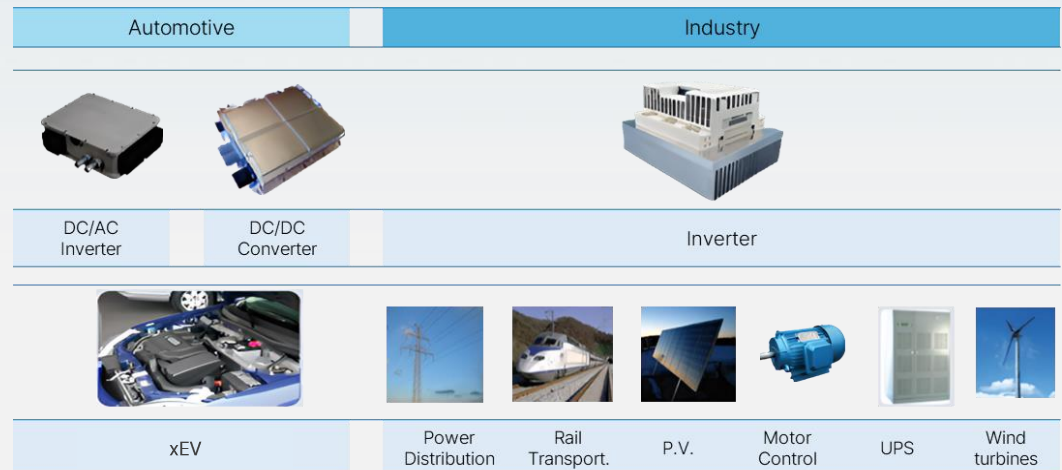
PCIM 2024 참가 (2024. 06, 독_뉘른베르그)

- 세라믹 방열 기판 제품 7종 소개
- 글로벌 전력반도체 파워모듈 기업, 자동차 제조사, 연구기관 및 대학 등 당사 방열 솔루션 관심 표명
- 글로벌 Top-Tier 전력반도체 기업들과 공동 개발 NDA 진행 / 진행 중
- 전기자동차 뿐만 아니라 다양한 Application에 적용 기대

글로벌 Si / SiC / GaN 전력반도체 주요 기업



전력반도체 파워모듈의 Application



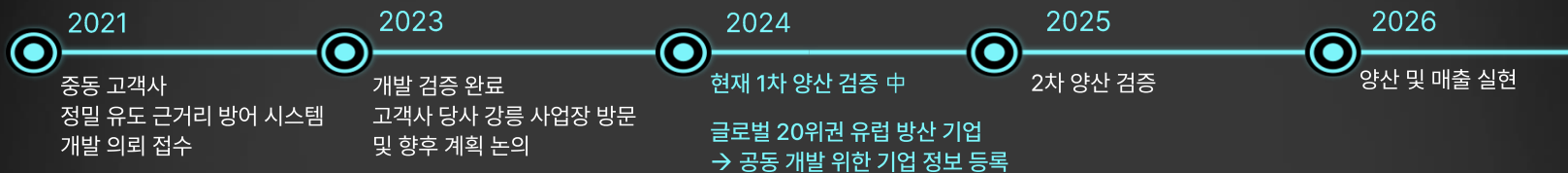
방위산업용 MCP 정밀 유도 근거리 방어 시스템용 MCP 모듈

중동 소재 글로벌 방산기업 _ 1차 양산 검증 진행 중

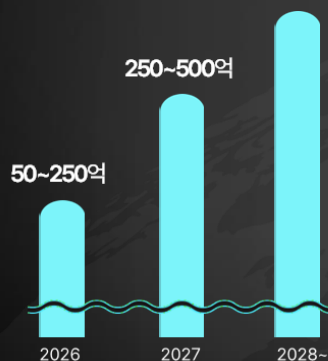
- 지정학적인 특성과 공급제품 특성 상, 양산 시작 이후 지속적인 대규모 매출이 발생하는 구조

공급 제품 특성 상 양산까지 장기간 소요되나, 제품 적용 후 장기간 안정적 매출 발생

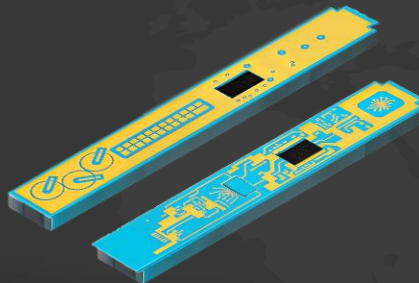
- 초기 설계 검토와 테스트를 거쳐 제품 적용까지 3~5년 소요
- 국내 방산 고객과도 프로젝트 진행 중



양산 및 매출 전망(E.)



MCP TRX 모듈



Eurosatory 2024 Paris 참가 (2024. 06)

- AESA Radar / 스마트안테나 / 위성통신용 MCP 제품 소개
- GaN 반도체 업체 / PCB 업체 등 당사 MCP 제품에 관심 표명
- 글로벌 20위권 유럽 방산 기업 → 구체적 협업 논의를 위한 RN2 계정 등록

2024년 하반기 전망

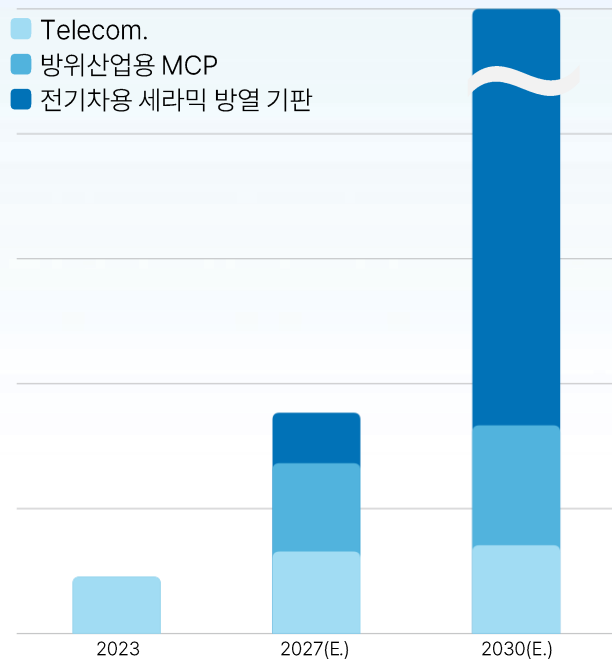
통신장비용 부품 사업군 점진적 회복 기대 및 Turn-around 달성

사업군 별 주요 내용	
무선통신장비용 부품	☒ 통신장비 회복 요인
	· 국내, 미국 2024년 하반기 주파수 경매 예상
	· 삼성전자 : 인도 통신사업자 Vi(보다폰아이디어) 4G, 5G 장비 공급 논의
	- VI : 가입자 1억명의 인도 3위 통신 사업자
	· 북미 통신사업자 verizon(버라이즌) 5G 통신 장비 투자 계획 발표
	- 자사 통신 서비스 품질 향상 목적, 2025년 본격화
	· 2023년 말 6G 후보 주파수 중 7GHz 대역의 주파수 부각
	- 주요 고객사와 관련 통신 부품 개발 중
방위산업용 MCP	☒ 1차 양산 검증 마무리 및 2025년의 2차 양산 검증 물량 수주 및 납품
	- 고객사와 지속 협의 및 진행 상황 점검 중
전기자동차용 세라믹방열기판	☒ 국내 고객사의 공동 개발 프로젝트 완료
	- 고객사와 지속 협의 및 진행 상황 점검 중
	☒ 글로벌 Top-Tier 전력반도체 고객사의 공동 개발 프로젝트 진행

Growth Road Map

기술 고도화 및 신사업 확대를 통한 Quantum Jump

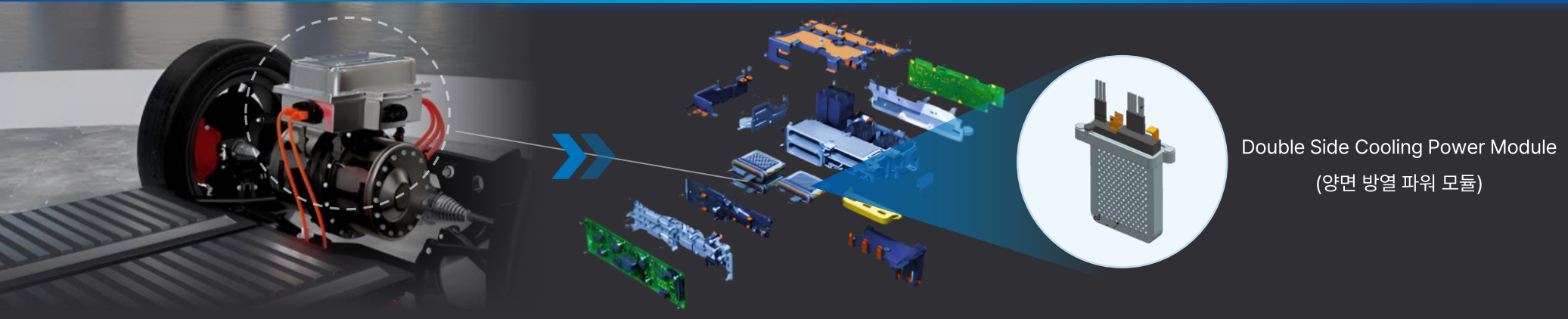
- 통신 장비용 제품의 안정적인 Cash Cow 유지 + 6G, 스마트폰 등 신규 매출 기회 모색
- 2025년 이후, 방산용 MCP의 양산 물량 공급 시작으로 퀀텀 점프 기대
- 전기자동차 등의 인버터용 세라믹 방열기판은 10년 이상의 장기 성장을 담보하는 핵심 기술



전기자동차 등 E-Mobility	Growth Engine
	·전기자동차 인버터용 세라믹 방열 기판
	·세라믹 전자부품 개발/생산 Know-How 기반
	·전기자동차 등 E-Mobility(수소차, UAM 등) 시장으로 도약
방위산업용 등 MCP	·글로벌 Top-Tier 전력반도체 기업들과 공동 개발 진행 중
	Growth Engine
	·20년 이상의 MCP 공정 Know-How
Telecommunication	·다양한 고객의 Needs 충족
	Cash Cow
	·안정적인 매출 성장 견인
	·Ant. 등 신규 사업 기회 모색
	·원천 소재 기술 기반 확대

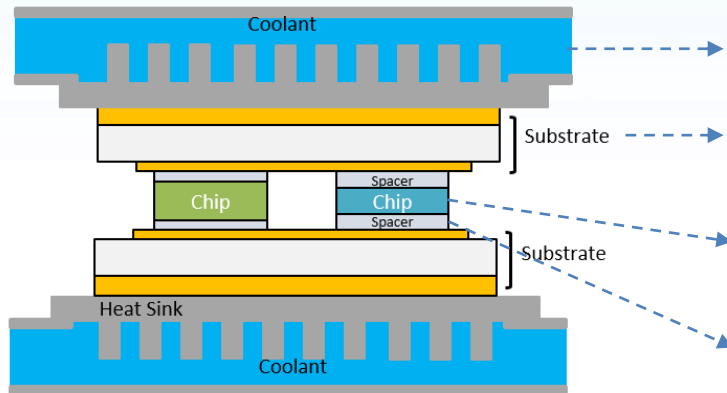
세라믹 방열 기판 전력반도체 파워 모듈용

고전력의 전기 동력 구동 시 인버터 모듈의 전력반도체에서 **발생되는 열을 제거하기 위한 핵심부품**으로 전기자동차 인버터 모듈의 필수 부품



Double Side Cooling Power Module
(양면 방열 파워 모듈)

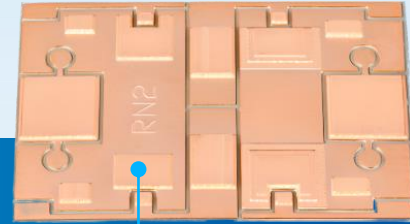
현재 전기자동차에 사용중인 양면 방열 파워 모듈의 단면 구조



냉각용 Coolant	방열 특성을 극대화하기 위해 냉매를 사용
Substrate(세라믹 방열 기판)	열 전달 특성이 뛰어난 세라믹 기판 양면에 얇은 구리판을 고온에서 접합시킨 세라믹 방열 기판
Si 또는 SiC 전력 반도체	배터리의 전력을 변환하고 조정하여 모터로 전달 → 작동 중 고온의 열 발생
Spacer	두께가 상이한 전력 반도체 Chip을 세라믹 방열 기판에 실장하기 위해 사용되는 높이 편차 보정 부품 → 고가의 Mo-Cu 합금 사용

세라믹 방열 기판 전력반도체 파워 모듈용

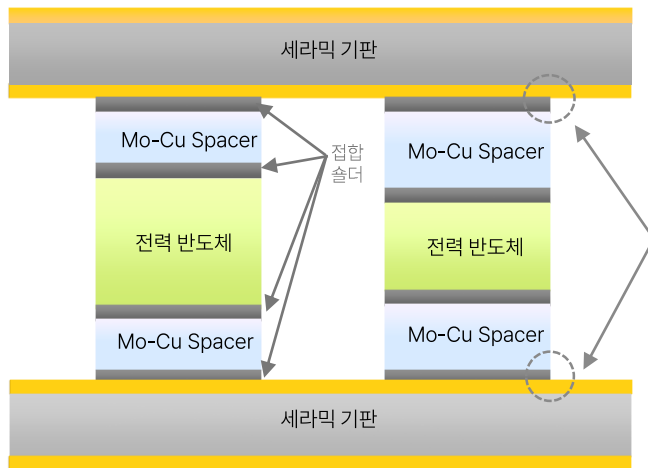
특허를 보유한 알엔투테크놀로지의 고유 기술력



3D 구조 형성 핵심 기술 특허 4건 보유 및 추가 9건 국내외 출원 中

기존 세라믹 방열 기판

Substrate(세라믹 방열 기판)와 고가의 Spacer를 각각 사용



접합

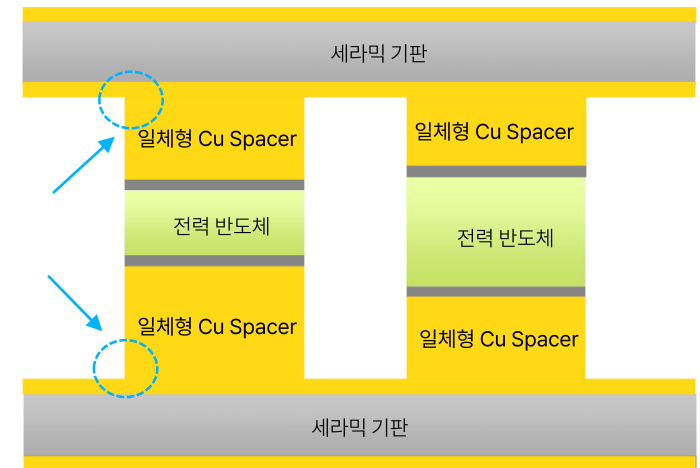
- 접합 공정 필요
- 조립 불량 가능성
- 열 저항 및 신뢰성 문제 가능성

스페이서 일체형 세라믹 방열 기판

Substrate(세라믹 방열 기판)와 일체화된 Spacer를 구현
→ 가격 경쟁력 확보 및 방열 효과 개선 등 다양한 이점 확보

일체형 Cu Spacer

- 접합 공정 감소
- 조립 불량 감소
- 열 저항 개선 효과
- 신뢰성 향상
- 고가의 Mo-Cu 미사용



세라믹 방열 기판 전력반도체 파워 모듈용

3D 구조 형성 핵심 기술 특허 4건 보유 및 추가 9건 국내외 출원 中

· 2015년부터 관련 기술 개발

· 세라믹 방열 기판 → 글로벌 Top-Tier 전력반도체 기업들과 공동 개발 진행 중

2015	세라믹 방열 기판 관련 기술 개발 시작	2023	국내 완성차 업체와 신규 개발 프로젝트 진행
	기존 방식의 단점을 보완할 수 있는 기술 채용		신축공장 포함 설비 투자 검토
2019	국내 가전업체 L사 검토 및 테스트 시작	~2024	국내 완성차 업체 개발 검증
2020	국내 자동차 부품제조사, 국내 완성차 업체 검토 및 테스트 시작		강릉 사업장으로 사업장 통합
	국내 자동차 부품 제조사 양산라인에서 제작된		PCIM(세계전기동력기술전시회) 참가 _ 독, 뉘른베르그
2021	방열 기판 모듈 신뢰성 평가 완료	~2025	글로벌 Top-Tier 전력 반도체 기업들과 공동 개발 시작 (기타 산업용으로 확장 가능성)
	국내 완성차 업체 Feasibility 검증 완료		당사 제품 적용 양산 차종 선정
	핵심 기술 특허 3건 등록	~2026	국내 완성차 업체 양산 검증 후 양산 시작
2022	국내 완성차 업체 양면 방열 모듈 샘플 제작 및 조립 검증		

(* 이후 일정은 변동될 수 있음)

세라믹 방열 기판 전기자동차용 시장 전망

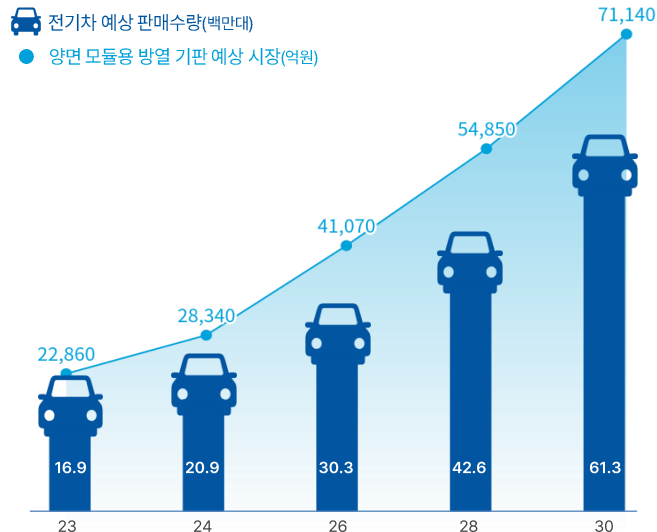
전기자동차 대당 세라믹 방열 기판 사용량(E.)

차량 종류	인버터 수량	세라믹 방열 기판 사용 수량
2륜 구동	1~2개	3~6장
4륜 구동	4개	12장
하이브리드	1개	3장

2030년 현대, 기아자동차 전기자동차 생산대수(E.)

차량 종류	현대	기아	합계
전기자동차	2백만대	1.8백만대	3.8백만대
하이브리드	0.9백만대	0.8백만대	1.7백만대

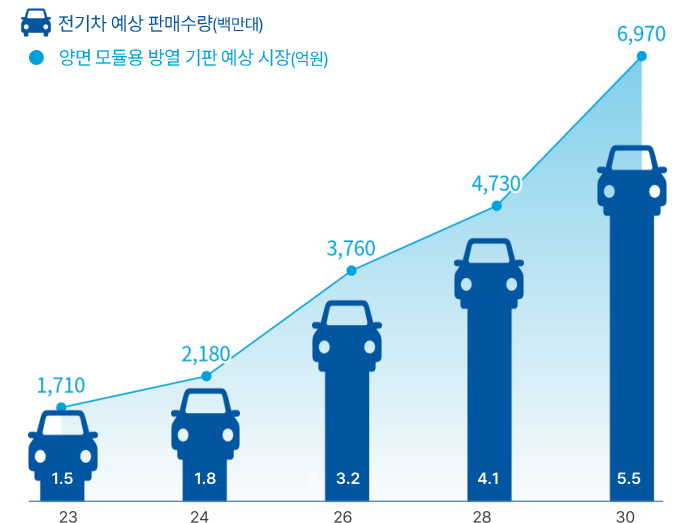
전기차용 양면 모듈용 방열 기판 - 세계 시장 규모(E.)



· 세계 전기차 예상 판매수량: SNE Research (2022.03)

· 세계 양면방열모듈용 기판 시장: 당사 추정

양면 모듈용 방열 기판 - 현대, 기아자동차(E.)



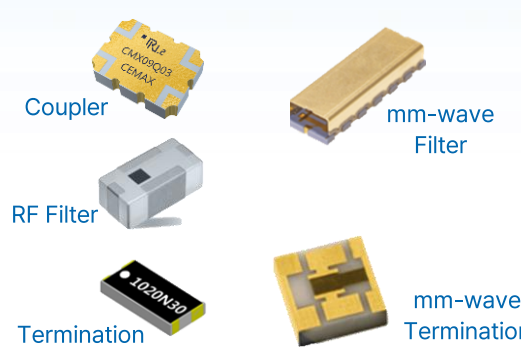
· 현대기아 전기차 예상 판매수량: 2023 각사 CEO Investor Day

· 현대기아 방열기판: 당사 추정

Telecommunication

기존 사업역량 강화 및 신규 사업기회 모색으로 안정적 매출 성장 견인

- Coupler, Termination 시장점유율 확대 및 5G/6G 대응 통신 부품 개발 공급
- 안정적인 글로벌 Big5 통신 장비업체향 공급을 통한 Cash Cow 역할
- 스마트폰, MCP UWB Ant. 등 당사 조성 특허를 보유한 소재 기반의 신규 진입 기회

통신장비용 부품	휴대폰용 부품	5G/6G 대응 소재
기존 사업역량 강화	신규 사업 기회 모색	소재 기반 원천기술 확보
· Coupler, Termination 시장 점유율 확대 추진 · 5G/6G 대응 통신 부품 개발(mm-wave 대역) · 자동차/방산용 확대 추진	· 당사 조성 특허 보유 소재 기반 · 스마트폰용 MCP UWB Ant. - 기존 제품 대비 장점 有 - 안테나 업체와 검토 中	· mm-wave 대역 소재 개발 - 세라믹 폴리머 복합 소재 · 회로 형성을 위한 신규 공정 기술 개발 - Lithography - 3D Ink Jet Printing 등
 Coupler RF Filter Termination mm-wave Filter mm-wave Termination	 휴대폰용 MCP UWB-Antenna	 Hybrid-MCP 소재 For 5G/6G

2024년 Marketing 방열 기판, 방위산업용 MCP

동력기술 전시회(PCIM) 및 방산 전시회(Eurosatory) 참가로 글로벌 영업 활동 적극 전개

	전기동력기술 전시회	성과
	·전력전자(Power Electronics) 분야 전문 기업 중심 전시회 ·약 10,000명의 전문적인 업계 관계자 방문 ·참가기업: 약 600개 ·장소: 독일, 뉘른베르크 ·일정: 2024.06.11.~2024.06.13.	·세라믹 방열 기판 제품 7종 소개 ·글로벌 전력반도체 기업, 자동차 제조사, 연구기관 등 방문 ·<u>글로벌 Top-Tier 전력반도체 기업들과 공동 개발 진행 중</u> ·<u>전기차 외 다양한 산업군의 애플리케이션에 적용 기대</u>
	방위산업 전시회	성과
	·글로벌 3대 방위산업 전시회 ·2년마다 개최되는 육상 및 항공 관련 국제 방위 및 보안 전시회 ·참가기업: 약 1,800개 ·장소: 프랑스, 파리 ·일정: 2024.06.17.~2024.06.21.	·AESA 레이더를 포함하는 방위산업용 레이더 등에 적용가능한 MCP 제품 소개 ·유럽 소재 방산기업을 포함한 반도체 파운드리 업체 등 방문 ·글로벌 20권의 유럽 소재 방산 기업에 구체적 협업논의를 위한 RN2 계정 등록

A close-up, low-angle shot of a scientist wearing a white lab coat, safety goggles, and a white hairnet. The scientist is focused on a task, with their hands visible in the foreground. The background is a blurred laboratory setting with various pieces of equipment and warm, bokeh-style lighting.

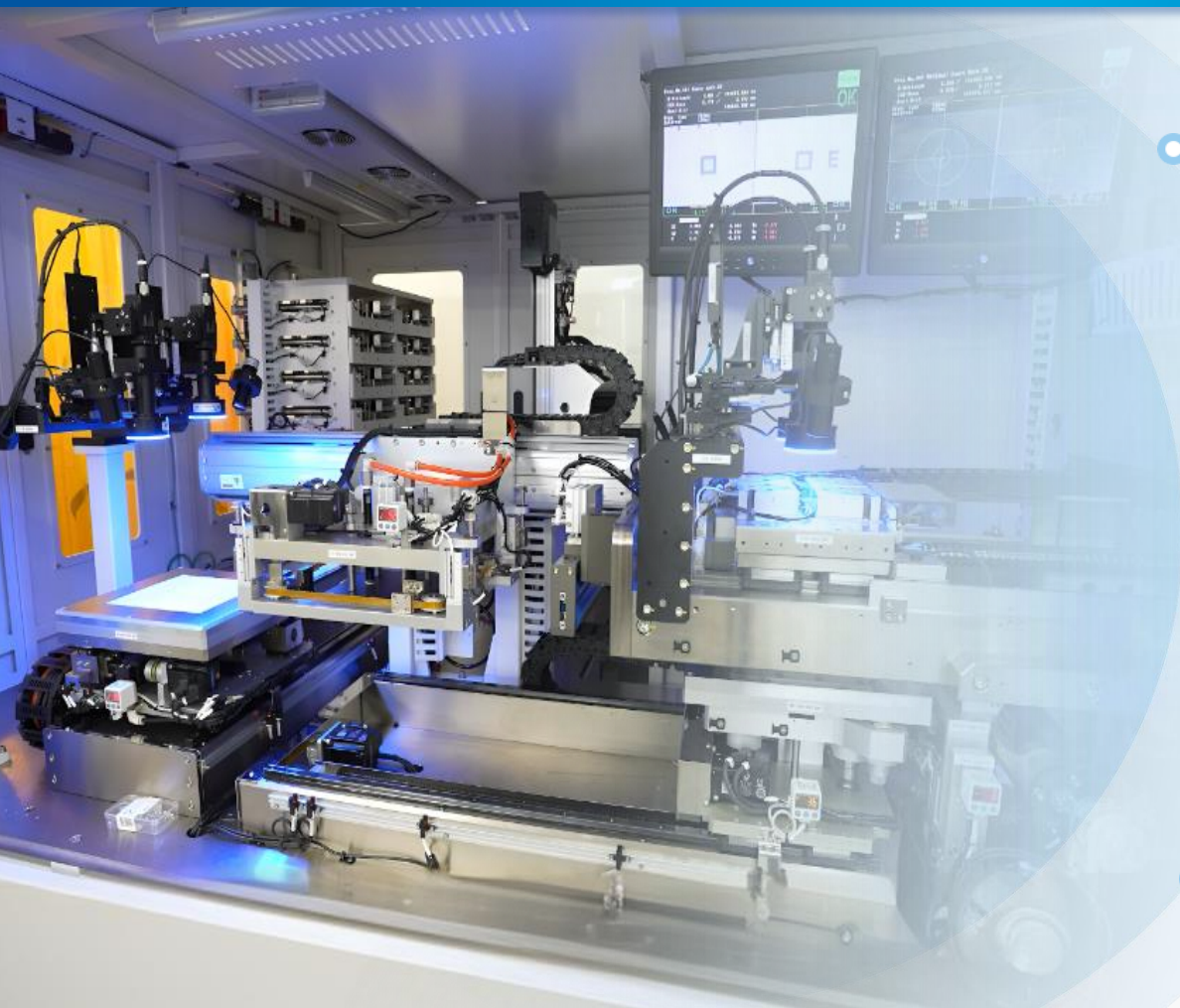
03

R&D

- Tech. Background for Growth
- 2024년 R&D

Tech. Background for Growth

세라믹 원천 소재기술 기반으로 관련 기술의 적용 제품 군 별 확대 적용



IP

- 전자부품용 세라믹 원천 소재 기술
- 5G 등 무선통신 관련 제품 설계 기술
- 등록: 24건의 소재, 공정, 회로 관련 IP 보유
- 출원: 10건의 공정, 회로 관련 IP

소재

- 전자부품용 MCP 세라믹 소재 원천 기술 기반
- 6G 대응 원천 소재 기술

Design

- 세라믹 전자 부품 설계 및 Simulation 기술
- 설계 및 제조 공정의 융합 기술

제조

- 20년 이상의 MCP 공정 기술 축적
- 전자부품 회로 구현 기술 축적

Network

- 응용제품 별 요구 기술 개발을 위한
협업 Network[한국생산기술연구원, 서울대,
한국항공대, 강릉원주대, 피츠버그공대(미)]
- 6G 대응 원천 소재 기술

2024년 R&D 방열 기판, 통신장비 부품 / 소재

고객 Needs 및 Technical Road Map

전기차용 세라믹 방열 기판	통신장비용 부품	국가지원 개발 과제
양면 방열 모듈 구성품 추가 개발	주요 고객사 통신부품 개발 진행	세라믹 방열 기판 개발
·세계 유일의 3D 구조 형성에 관한 독자 기술 기반	·삼성전자, 노키아, 에릭슨, 화웨이, ZTE 등 주요 고객사	·기간: 2024~2027년, 24억원
·냉각핀 일체형 세라믹 방열 기판 개발 中	- 5~7GHz 대역: 4건	·세라믹 방열기판 개발 2건
·열 전달 최종 부분인 냉각판과 냉각핀을 Cu 소재로 일체화 구현	- 3~6GHz 대역: 10건	·한국생산기술원 등과 공동 개발 진행
·접합공정 불필요, 세라믹 기판 휨 방지 등 다양한 이점 확보	- 기타: 3건	mm-wave용 통신 부품 개발
	·고객사의 Needs에 따라 연간 25건 이상의 신규 통신 장비용 부품 개발 진행	·기간: 2023~2024년, 4.5억원
		·초고주파 대역 Coupler/filter 개발 진행
		6G 이동통신용 차세대 기판 소재
		·기간: 2021~2024년, 15억원
		·ATC+우수기업부설연구소 육성 사업
		·피츠버그대학교, 한국항공대학교와 공동 개발 진행

A hand is pointing at a digital financial chart. The chart features various data series, including a prominent orange bar chart and a blue line graph. The background is a blurred image of a city at night with blue and orange lights. The number '04' is overlaid in a large, blue, semi-transparent font.

04

Financial Information

- 요약 재무제표(연결)
- 요약 재무제표(별도)
- 매출실적

요약 재무제표(연결)

(단위: 백만원)

	2022	2023	2024 Q2
유동자산	31,402	23,891	23,397
비유동자산	30,069	25,747	23,370
자산 총계	61,471	49,638	46,767
유동부채	16,012	8,996	8,907
비유동부채	2,310	1,765	497
부채 총계	18,322	10,761	9,403
자본금	3,823	3,823	3,823
자본잉여금	25,195	25,195	25,195
자본조정	(2,453)	271	(313)
이익잉여금	16,584	9,587	8,659
자본 총계	43,149	38,877	37,364

(단위: 백만원)

	2022	2023	2024 Q2
매출액	23,281	14,687	6,704
매출원가	11,089	8,563	4,273
매출총이익	12,192	6,123	2,431
판매비와관리비	8,912	7,573	3,776
영업이익	3,280	(1,450)	(1,345)
영업외수익	3,914	2,253	1,230
영업외비용	4,450	1,172	354
법인세차감전 순이익	2,744	(969)	(469)
법인세비용(수익)	(384)	(309)	148
계속영업이익(손실)	3,128	(660)	(616)
중단영업이익(손실)	(3,248)	(3,026)	
당기순이익	(119)	(3,686)	(616)

요약 재무제표(별도)

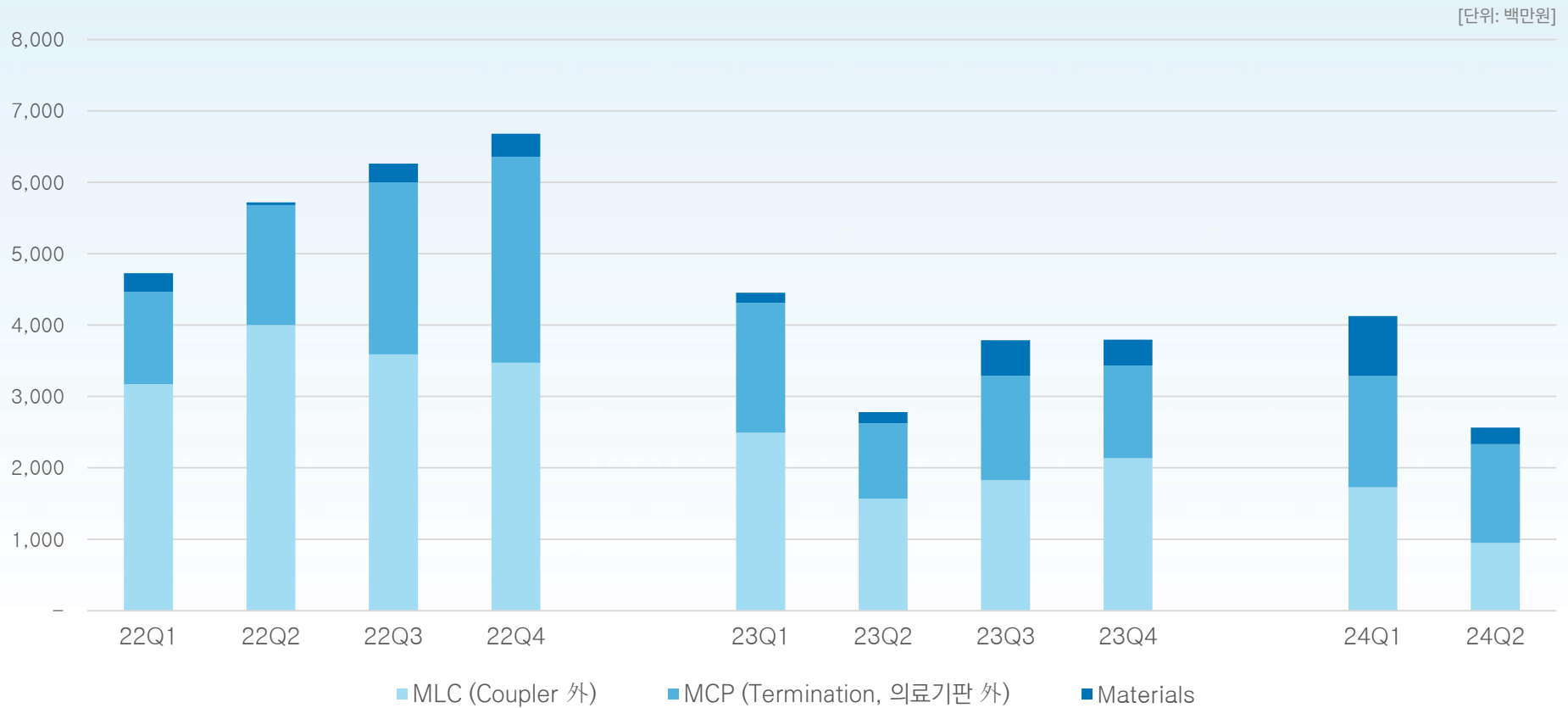
(단위: 백만원)

	2022	2023	2024 Q2
유동자산	30,127	21,529	21,561
비유동자산	31,659	29,422	27,182
자산 총계	61,786	50,952	48,743
유동부채	15,758	8,911	8,851
비유동부채	2,322	1,785	517
부채 총계	18,081	10,696	9,367
자본금	3,823	3,823	3,823
자본잉여금	25,195	25,195	25,195
자본조정	(2,453)	271	(316)
이익잉여금	17,140	10,966	10,673
자본 총계	43,706	40,256	39,376

(단위: 백만원)

	2022	2023	2024 Q2
매출액	23,251	14,601	6,695
매출원가	11,089	8,563	4,273
매출총이익	12,162	6,038	2,422
판매비와관리비	8,372	6,779	3,104
영업이익	3,790	(742)	(682)
영업외수익	3,960	2,360	1,202
영업외비용	4,449	1,769	353
법인세차감전 순이익	3,301	(151)	168
법인세비용(수익)	(384)	(310)	149
계속영업이익(손실)	3,685	159	19
중단영업이익(손실)	(3,248)	(3,026)	
당기순이익	437	(2,868)	19

매출 실적



Disclaimer

본 자료에 포함된 (주)알엔투테크놀로지(이하 '회사')의 경영실적 및 재무 성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준 및 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 향후 매출 계획 등 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.

이는 과거가 아닌 미래의 추정에 기인하여 성장 가능한 목표치를 경영실적으로 반영하고 있으며, '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 용어를 사용하였습니다.

위 '예측정보'는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며, 이러한 불확실성에 따른 현상은 미래의 경영실적과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 각종 지표들은 현재의 시장상황과 회사의 경영목표 및 방침을 고려하여 작성된 것으로 시장환경의 급속한 변화 및 투자환경, 회사의 전략적 목표 수정에 의하여 그 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.

따라서, 투자자는 투자 판단을 내리기에 앞서 반드시 회사의 공시사항을 확인하여야 하며, 본 자료에 열거한 사항은 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 효과를 미치지 못하므로 법적 책임이 없습니다.

